



Grundsteinlegung 300-Millimeter-Halbleiterwerk Dresden

25. Juni 2018
PI 10675 AE Ka/af

Allgemeine Informationen

- | | |
|----------------------------------|---|
| ▶ Investitionssumme | rund eine Milliarde Euro |
| ▶ Grundstück | ca. 100 000 m ²
(ca. 14 Fußballfelder) |
| ▶ Gesamtnutzfläche | ca. 72 000 m ² Fertigungs-
und Büroflächen |
| ▶ Bauverlauf | Spatenstich Frühjahr 2018,
Maschineninstallation Mitte/Ende 2019,
Pilotproduktion ab Ende 2021 |
| ▶ Mitarbeiter im Endausbau | bis zu 700 |
| ▶ Gesuchte Berufsqualifikationen | Experten aus der Halbleiterindustrie,
wie Prozess-, Produktions- oder
Instandhaltungsingenieure,
Mathematiker, Softwareentwickler
sowie Berufserfahrene aus
Studienrichtungen wie Physik, Chemie
und Mikrosystemtechnik |
| ▶ Fertigungstechnologie | Hochautomatisierte Halbleiterproduktion
(300-mm-Siliziumsubstrate (Wafer)
mit Strukturbreiten bis 65 nm;
1 nm ist ein Millionstel Millimeter) |

- ▶ Vernetzte Produktion
Pro Sekunde übertragen die Maschinen ein Gigabit Produktionsdaten. Täglich entstehen Datenmengen, die umgerechnet mehr als 42 Millionen beschriebene Blatt Papier mit einem Gewicht von 22 Tonnen ergäben.

Informationen zum Bauwerk

- ▶ Gesamtbaumasse 600 000 m³
- ▶ Betonbedarf ca. 66 500 m³
(etwa 8 300 LKW-Betonmischer)
- ▶ Stahlbedarf ca. 16 400 Tonnen
(etwa 30 A380-Passagierflugzeuge)
- ▶ Erdbewegungen/-aushub ca. 90 000 m³
(etwa 7 500 Lkw-Ladungen)
- ▶ Bohrfähle für das Fundament ca. 860 Stück
- ▶ Bodenplatte 100 cm Dicke
- ▶ Länge der Rohrleitungen ca. 80 km
- ▶ Länge der Elektroleitungen ca. 380 km
(2 x Strecke Berlin-Dresden)

Internetquellen

- ▶ Stellenbörse für Bewerber www.bosch-career.de/jobs
- ▶ Standortseite Dresden www.bosch.de/unser-unternehmen/bosch-in-deutschland/dresden
- ▶ Halbleiter von Bosch www.bosch-semiconductors.com